

## Infoblatt zu benötigten Leiterplattendaten und deren Verwendung durch sas-electronics:

### 1.) Sprache

Alle Texte in den Unterlagen müssen in englischer Sprache zu Verfügung gestellt werden.

Angaben in anderen Sprachen werden nicht berücksichtigt.

### 2.) Fertigungsdaten

Bitte stellen Sie uns alle zur Fertigung der Leiterplatte notwendigen Dateien in folgenden Formaten zur Verfügung:

- Extended Gerber Format RS274-X
- ODB++
- Formate für Bohrprogramme: Excellon (2) / Sieb & Meyer (1000 od. 3000)

Andere Formate können nicht über den Online-Shop verwendet werden.

Die Lagenreihenfolge von Mehrlagenleiterplatten muss klar gekennzeichnet sein.

Die Ober- und Unterseite der Leiterplatte muss klar gekennzeichnet sein, um eine seitenverkehrte Produktion der Leiterplatten auszuschließen.

Der Verwendungszweck und die Zuordnung der einzelnen Dateien muss definiert sein.

### 3.) Sonstige Angaben zur Leiterplatte

Alle relevanten Daten zur Leiterplattenspezifikation können über unsere Kalkulationsmaske im Online-Shop eingegeben werden und werden als Leiterplattenspezifikation verwendet.

Sollten zusätzliche Unterlagen zur Leiterplattenfertigung nötig sein, wie z. B. Nutzenzeichnung zur Nutzenerstellung, Lagenaufbauten, Impedanz-Vorgaben, etc. stellen Sie diese Unterlagen bitte in englischer Sprache zur Verfügung.

### 4.) Bereitstellung der Daten

Bitte „zippen“ Sie alle benötigten Unterlagen in einem komprimierten Ordner zusammen, und laden Sie diesen komprimierten Ordner später im Bestellvorgang auf unseren Server (Upload).

Vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Daten im komprimierten Ordner enthalten sind und sinnvoll benannt sind.

**Bitte entfernen Sie alle anderen Dateien, sowie Hilfs-Dateien, die nicht zur Fertigung benötigt werden um Missverständnisse oder unnötige Rückfragen zu vermeiden.**

Anbei ein Beispiel anhand einer Checkliste zur Benennung von Gerberdaten - in Klammern sehen Sie mögliche international bekannte Dateiendungen:

Außenkontur (.gko) / Top-Lage (.gtl) / Innenlagen (.l2-.l6) / Bottom-Lage (.gbl) / Lötstopplack Top + Bottom (.gts+.gbs) / Pastendaten Top + Bottom (.gtp+.gpb) / Bohrprogramm(e) (.drl / .npth / .pth) / Angaben zum Ritzen (.v-cut) / Fräsprogramm (.rou)

Nutzenzeichnung (Panel-drawing) / Lagenaufbau (Layer-Stack-up) / Impedanz-Angaben (Impedance)

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Dateien wie gefordert zur Verfügung zu stellen, kontaktieren Sie uns bitte und senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an [contact@sas-electronics.de](mailto:contact@sas-electronics.de). Wir unterbreiten Ihnen dann schnellstmöglich ein individuelles Angebot.

## **5.) Verwendung und Aufbereitung der Daten**

Die zu Verfügung gestellten Dateien werden ausschließlich zur Fertigung von Leiterplatten verwendet und von uns der Produktionsstätte zur Verfügung gestellt.

Bei unterschiedlichen bzw. widersprüchlichen Angaben in den Daten oder zu Ihren Angaben zur Leiterplattenkalkulation behalten wir uns das Recht vor, nach besten Wissen und Gewissen zu entscheiden, welche Angabe sinnvoller erscheint und diese ohne weiteres Nachfragen entsprechend umzusetzen.

Die Daten werden durch die Produktion entsprechend den jeweiligen Produktionsparametern aufbereitet. Dabei können durch die Produktion ohne Rückfrage Anpassungen vorgenommen werden, um die benötigten Produktionsparameter einzuhalten und die Fertigung zu ermöglichen.

## **6.) Wertigkeit der Angaben / Daten**

In der Regel gilt folgende Reihenfolge zu Befolgung der Angaben, diese kann jedoch von uns jederzeit geändert werden, wenn dies sinnvoll erscheint:

- Angaben zur Kalkulation der Leiterplatte auf unserer Homepage.
- Leiterplattenspezifikation, Zeichnungen, Änderungshinweise
- Gerberdaten
- Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
- allgemein international gültige Normen zur Leiterplattenfertigung (z.B. IPC A-600 in der aktuell gültigen Fassung)